

Veranstaltungshinweise

Kongressort

Der Kongress wird im Konferenzzentrum (Stadhalle) der Stadt Fürth veranstaltet. Es besteht direkter U-Bahn-Anschluss zum Flughafen Nürnberg sowie zum Fürther und zum Nürnberger Hauptbahnhof.

Kongresssprachen

Die Kongresssprachen sind Deutsch und Englisch. Eine Simultanübersetzung der Vorträge erfolgt in Deutsch und Englisch.

Begleitende Industrieausstellung

Die Veranstaltung wird durch eine begleitende Industrieausstellung und eine Posterpräsentation ergänzt.

Besichtigungen

Am Freitag, den 21.09. 2012 sind Besuche bei MID-Herstellern, -Anwendern und Forschungsinstituten geplant.

Gastvorträge

Das Fachprogramm wird ergänzt durch eingeladene Experten aus Industrie und Forschung, die zu übergreifenden Entwicklungen der MID-Technik vortragen werden.

MID-Förderpreis 2012

Im Rahmen der Konferenz wird der MID-Förderpreis 2012 der Forschungsvereinigung verliehen. Mit dem Preis wird eine herausragende Entwicklungsarbeit aus dem Umfeld der MID-Technik gewürdigt.

Mehr Informationen?

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zur MID-Technologie und später eine Einladung zum Kongress. Oder wollen Sie als Aussteller am Kongress teilnehmen? Bitte senden Sie uns eine kurze Nachricht: info@3dmid.de



Kongresskomitee

Internationales Programmkomitee aus Wissenschaft und Industrie

- A. Birkicht – HARTING AG, CH
- R. Süß-Wolf – Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG, DE
- D. Drummer – Universität Erlangen-Nürnberg, DE
- K. Feldmann – Forschungsvereinigung 3-D MID e.V., DE
- J. Franke – Universität Erlangen-Nürnberg, DE
- J. Hehlhans – HARTING Electric GmbH & Co. KG, DE
- M. Hellmich – MID Solutions GmbH, DE
- J. Heyer – Enthone GmbH, DE
- W. John – LPKF Laser & Electronics AG, DE
- I. Kriebitzsch – BMW AG, DE
- H. Kück – HSG-IMAT, DE
- E. McMillan – Molex Inc., CN
- T. Niino – University of Tokyo, JP
- A. Pojtinger – 2E mechatronic GmbH & Co. KG, DE
- M. Römer – KOSTAL GmbH, DE
- H. Rohde – Robert Bosch GmbH, DE
- V. Zeiher – BASF SE, DE
- V. Zippmann – Buss GmbH & Co. KG, DE

Organisationskomitee

- A. Birkicht – HARTING AG, CH
- J. Franke – Forschungsvereinigung 3-D MID e.V., DE
- W. John – LPKF Laser & Electronics AG, DE
- M. Müller – Forschungsvereinigung 3-D MID e.V., DE

Kontakt

Geschäftsstelle 3-D MID e.V.

Martin Müller
Forschungsvereinigung 3-D MID e.V.
Nordostpark 91
D-90411 Nürnberg
Telefon: +49.911.580 58.17
Telefax: +49.911.580 58.30
E-Mail: info@3dmid.de

Internet

Weitere Informationen über den Kongress und Hinweise für die Autoren finden Sie auf den Kongressseiten unter:

www.3dmid.de

CALL FOR PAPERS



10. Internationaler Kongress

Molded Interconnect Devices

Kongresszentrum Fürth
Metropolregion Nürnberg
19. – 20. September 2012

veranstaltet von der

Forschungsvereinigung Räumliche
Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.

in Zusammenarbeit mit der

Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik – FAPS



Innovation mit MID: Serienreife Produktkonzepte und alternative Herstellungsverfahren

Neueste Serienanwendungen zur MID-Technik und das zunehmende Angebot an innovativen Fertigungslösungen für räumliche spritzgegosene Schaltungsträger unterstreichen nachdrücklich den wachsenden Markterfolg dieser Technologie. Innovative Baugruppen- und Anlagenfertiger können in der MID-Technologie deutliche Wachstumsraten verzeichnen. Die direkte Applizierung der Elektronik auf thermoplastischen, dreidimensionalen Substraten bietet vielfältige Gestaltungs- und Rationalisierungspotenziale für mechatronische Systeme.

Für die erfolgreiche Umsetzung dieser innovativen Elektroniktechnologie und eine stabile Einschätzung der Wachstumsbereiche können aktuelle Informationen und Fachgespräche wichtige Impulse setzen. Die Konferenzen zur MID-Technik in der Metropolregion Nürnberg sind inzwischen zu einem auch international anerkannten Forum dieser Technologie geworden.

Die Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V. will mit der 10. Konferenz thematische Schwerpunkte zu Produkten, Herstellungsverfahren, Fertigungstechnologien und Einführungsstrategien setzen. Die Tagung findet im Fürther Konferenzzentrum statt. Ergänzend ist eine umfangreiche Industrieausstellung im Ausstellungsbereich geplant.

Einladung zu Fachbeiträgen

Experten aus Industrie und Forschung sind eingeladen, einen Vortrag zu den nebenstehenden Themenfeldern einzureichen. Bitte senden Sie uns Ihre Kurzfassung des Vortrags mit einem maximalen Umfang von 500 Wörtern auf einer DIN A4 Seite mit folgenden Angaben:

- Titel des Vortrags
- Zuordnung zum Themenfeld
- Name und Adresse des Autors

Eine Vorlage finden Sie auf den Kongressseiten im Internet zum Download. Bitte beachten Sie die unten angegebenen Termine. Die Auswahl der Beiträge erfolgt durch das Programmkomitee. Alle angenommenen Beiträge werden in den Proceedings zum Kongress veröffentlicht. Informationen werden separat durch das Kongressbüro zugesandt. Für Referenten ist der Besuch der Tagung kostenfrei.

Wichtige Termine

- | | |
|--|------------------------|
| • Einsendeschluss der Kurzfassungen | 1. März 2012 |
| • Informationen über Programmauswahl | 16. April 2012 |
| • Einsendeschluss der Kongressvorträge | 30. Juli 2012 |
| • Kongress MID 2012 | 19.–20. September 2012 |

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge zu den Themen:

1. Innovationen in MID

- Integrative Produktkonzepte
- Wirtschaftliche Aspekte
- Markterschließung

2. MID – Anwendung und Realisierung

- Erweiterter Nutzen durch MID
- Auswahl von MID-Herstellungsverfahren
- Strategien für erfolgreiche MID-Projekte

3. Integrierte CAD/CAM-Systeme

- Entwicklungssysteme ECAD/MCAD
- 3D-MID Layout und Design
- Simulation

4. Materialien für MID

- Einsatz neuer Substrate/Folien
- Schaltungsträger-Oberflächen
- Verbindungsmedien

5. Kunststoffverarbeitung

- 1K-/2K-Spritzguss
- Sonderverfahren
- Gestaltungsrichtlinien

6. Metallisierungsverfahren

- Alternative Oberflächenbeschichtungen
- Stromtragfähigkeit, Haftfestigkeit
- Anforderungen für die Verbindungstechnik

7. Strukturierung von Leiterbahnen

- 3D-Fähigkeit
- Flexibilität
- Strukturgrößen

8. Aufbau- und Verbindungstechnik

- Bestücken: SMT, Chip on MID
- Alternative Lötverfahren, Leitleben
- Systemlösungen für MID, Folie

9. Qualitätssicherung

- Qualitätssichernde Maßnahmen
- Umweltschutz, Recycling
- Prüfmethodik, Standards

10. Zukünftige Entwicklungen

- Drucktechnologien
- Alternative Aufbautechnologien
- Rapid Prototyping/Manufacturing

Automobilindustrie

Drucksensor

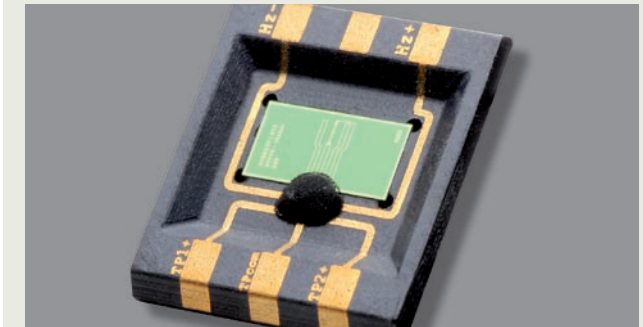
Quelle: Robert Bosch GmbH



Klimatechnik

Strömungssensor

Quelle: 2E mechatronic GmbH & Co. KG



Luft- und Raumfahrt

Passiver UHF Transponder

Quelle: HARTING AG Mitronics

